

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
成都蓉微微波电子科技有限公司 （以下简称“成都蓉微”）	1,000 万元	2,050 万元	是	否
成都鸿立芯半导体有限公司 （以下简称“鸿立芯”）	1,000 万元	2,650 万元	是	否
安徽鸿安信电子科技有限公司 （以下简称“鸿安信”）	2,000 万元	0 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	59,700
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	13.50
特别风险提示（如有请勾选）	☐对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☐担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☒对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技有限公司（以下简称“公司”或“鸿远电子”）于 2026 年 8 月 10 日与中国银行股份有限公司成都武侯支行、中国银行股份有限公司成都金牛支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》分别为成都蓉微、鸿立芯、鸿安信提供担保债权最高本金余额 1,000 万元、1,000 万元、2,000 万元连带责任保证。鸿立芯的少数股东为员工持股平台，未提供同比例担保。上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司分别于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议、2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》。2026 年度，公司拟为子公司北京元陆鸿远电子科技有限公司、创思（北京）电子科技有限公司、北京鸿远泽通电子科技有限公司、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司、鸿立芯、成都蓉微、鸿安信向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币 11 亿元的担保。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体的《关于 2026 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2026-011）。

本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）成都蓉微微波电子科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	成都蓉微微波电子科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%

法定代表人	章莉		
统一社会信用代码	91510107752815819L		
成立时间	2003 年 8 月 21 日		
注册地	四川省成都市成华区成业路 6 号 9 栋 4 层 1、2 号房		
注册资本	5,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；通信设备制造；通讯设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	7,527.83	7,490.84
	负债总额	8,893.33	7,915.79
	资产净额	-1,365.50	-424.94
	营业收入	333.13	3,726.54
	净利润	-940.61	-3,130.60

（二）成都鸿立芯半导体有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	成都鸿立芯半导体有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	全资子公司元六鸿远（成都）电子科技有限公司持股 60%，成都芯远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 40%。

法定代表人	罗闯		
统一社会信用代码	91510100MA6CM3RE3K		
成立时间	2017 年 3 月 22 日		
注册地	成都高新区天虹路 3 号 B 幢 3 层		
注册资本	3,400 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；集成电路制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	23,200.27	23,634.31
	负债总额	21,545.93	21,140.42
	资产净额	1,654.34	2,493.89
	营业收入	1,144.30	10,293.59
	净利润	-839.73	395.59

注：截至目前，元六鸿远（成都）电子科技有限公司持有成都芯远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.25%出资份额，即公司间接持股鸿立芯71.70%。

（三）安徽鸿安信电子科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	安徽鸿安信电子科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	全资子公司元六鸿远（合肥）电子科技有限公司持股100%
法定代表人	丁小聪
统一社会信用代码	91340104MA2TGR3L9U
成立时间	2019 年 3 月 5 日

注册地	安徽省合肥市合肥经济技术开发区海恒社区宿松路3963号智能科技园D2栋103室		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电子元器件制造；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；电气设备销售；仪器仪表销售；机械设备租赁；通信设备销售；电子测量仪器销售；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	8,780.01	7,036.37
	负债总额	6,585.55	6,445.05
	资产净额	2,194.47	591.31
	营业收入	545.86	2,902.25
	净利润	-349.48	-2,487.54

三、担保协议的主要内容

（一）中国银行股份有限公司成都武侯支行

1、债权人：中国银行股份有限公司成都武侯支行

2、债务人：成都蓉微

3、保证人：鸿远电子

4、担保债权之最高本金余额：人民币 1,000 万元

5、担保方式：连带责任保证

6、担保范围：在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师

费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

7、担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求保证人承担保证责任。

（二）中国银行股份有限公司成都金牛支行

1、债权人：中国银行股份有限公司成都金牛支行

2、债务人：鸿立芯

3、保证人：鸿远电子

4、担保债权之最高本金余额：人民币 1,000 万元

5、担保方式：连带责任保证

6、担保范围：在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

7、担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求保证人承担保证责任。

（三）中国光大银行股份有限公司合肥支行

1、授信人：中国光大银行股份有限公司合肥支行

2、受信人：安徽鸿安信电子科技有限公司

3、保证人：鸿远电子

4、担保的主债权最高本金余额：人民币 2,000 万元

5、担保方式：连带责任保证

6、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和其他所有应付的费用、款项。

7、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营、财务状况等方面能够有效控制，可以及时掌控资信状况，鸿立芯少数股东为员工持股平台，未提供同比例担保，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》。

董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。公司于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了上述议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外提供的担保合同总额为人民币 59,700 万元，均为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保，占公司 2025 年度经审计净资产的 13.50%；公司实际对子公司提供的担保余额为人民币 9,966.58 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 2.25%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日